

小間No.

D-20

企業名

(株)イングスシナノ

企業概要

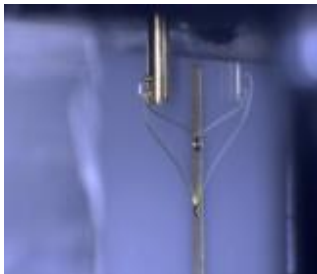
- 所在地 長野県諏訪郡下諏訪町四王5415
- 代表者 代表取締役社長 小林 秀年
- 資本金 2,000万円
- 従業員数 85人
- URL www.ings-s.co.jp
- 主要製品 『テストサンプル実装』から『評価』までをお受けできます。

展示品

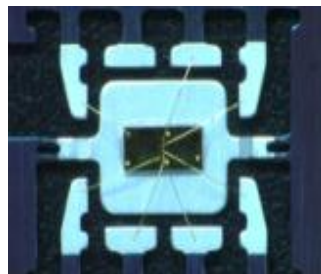
実装サンプル

加工技術・自社製品分野

- ・フリップチップボンダーによる高精度実装
- ・Au/Alワイヤーボンディング実装
- ・ACF実装



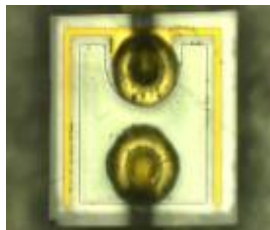
中継用同軸プラグ芯線からプリント基板へのワイヤボンディング



特殊機能チップのワイヤボンディング



超ロングループによるワイヤーボンディングのセンサー応用



発光素子の高精度ダイボンドとワイヤボンド



狭ピッチ細パターン配線基板のインターフェースFPCとの接合

当社の加工技術・自社製品の特徴

半導体ベアチップ実装引き受けます！

- ・基板1枚、チップ1個、ワイヤー1本から試作対応いたします。
- ・クリーンルームでの立会い実装が可能です。

お問合せ先・担当者

- 所属 FD営業グループ
- 役職 リーダー
- 氏名 原 斉

TEL 0266-27-8056
FAX 0266-28-0325
E-mail hara-hitoshi@ings-s.co.jp